## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2002-341530

(43)Date of publication of application: 27.11,2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/027 CO8F290/04

(21)Application number: 2001-144016 (22)Date of filing:

G03F 7/038

(71)Applicant: TOKYO OHKA KOGYO CO LTD.

14.05.2001 (72)Inventor: TAKANASHI HIROSHI

KUDOU TOMOYA OBATA TAKEKAZII

# (54) NEGATIVE WATER-SOLUBLE PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a negative water-soluble photosensitive resin composition which is a non-chromium photosensitive resin composition as a substitute for a conventional chromium-based water-soluble photosensitive resin composition, and in particular, which is preferably used for the formation of photomasks for etching metal substrates in the manufacture of shadow masks for CRTs, lead frames for IC chip mounting, or the like, and which has excellent water resistance of the film and durability against etching even though the composition can be developed with water.

SOLUTION: The negative water-soluble photosensitive resin composition contains (A) a watersoluble polymer containing a structure unit having carboxyl groups and a structural unit having at least one ethylenic double bond in the side chains, (B) a compound containing (meth) acrylamide methylene groups, which is obtained by the reaction of a compound having at least one alcoholic hydroxyl group in the molecule and, N-methylol (meth)acrylamide, C1-4 alkoxymethyl (meth)acrylamide in the presence of a strong acid catalyst, and (C) a photopolymerization initiator.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16 03 2005

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-341530 (P2002-341530A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G03F 7/027	503	G03F 7/027	503 2H025
C08F 290/04		C 0 8 F 290/04	4 J 0 2 7
G03F 7/038	501	G03F 7/038	5 0 1

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 13 頁)

(21)出願番号	特顧2001-144016(P2001-144016)	(71)出顧人	000220239 東京応化工業株式会社
(22)出顧日	平成13年5月14日(2001.5.14)	(72)発明者	神奈川県川崎市中原区中丸子150番地高梨 博
			神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東 京応化工業株式会社内
		(72)発明者	工藤 知哉 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東 京応化工業株式会社内
		(74)代理人	100098800 弁理士 長谷川 祥子

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 ネガ型水溶性感光性樹脂組成物

#### (57)【要約】

構成単位と、少なくとも1つのエチレン性ニ退結合を有 する構成単位を合んでなるが発達ポリマー、6 B 強酸 触媒の存在下、分子中に少なくとも1つのアルコール性 水酸基を含有する化合物と、Nーメチロール (メタ) ア リルアミド、Cn アルコキシメチル (メタ) アクリ ルアミドとを反応させて得られる生成物である (メタ) アクリルアミドメチレン基含有化合物、および (C) 光 重合開始剤を含有する、ネガ型木溶性感光性樹脂組成 物。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 側鎖に、カルボキシル基を有する 構成単位と、少なくとも1つのエチレン性二重結合を有 する構成単位を含んでなる水溶性ポリマー、(B)強酸 触媒の存在下、分子中に少なくとも1つのアルコール性 水酸基を含有する化合物と、下記一般式 (I)

$$\begin{array}{c} H_2C = C \\ I \\ I \\ C - N \\ CH_2OR_2 \end{array}$$

(式中、R:は水素原子またはメチル基を表し、R:は水 素原子または炭素原子数1~4のアルキル基を表す)で 表される化合物とを反応させて得られる、下記一般式

(式中、R,は、上記と同じ意味を表す)で表される (メタ) アクリルアミドメチレン基含有化合物、および (C) 光重合開始剤を含有する、ネガ型水溶性感光性樹

脂組成物。

(式中、R1は水素原子またはメチル基を表す)で表さ れる単位と、下記一般式 (IV)

$$\begin{array}{c|c}
-\begin{pmatrix} c \\ +_2 \end{pmatrix} & R_4 \\ COCCH_2CH-R_6-C-C \\ COCCH_2CH-R_6-C$$

(式中、R<sub>2</sub>、R<sub>4</sub>は、それぞれ独立に水素原子またはメ チル基を表し、R。は二価の炭化水素基を表す) で表さ れる単位を含む共重合体である、請求項1記載のネガ型 水溶性感光性樹脂組成物。

【請求項3】 (B) 成分を形成する、分子中に少なく とも1つのアルコール性水酸基を含有する化合物が、多 価アルコールである、請求項1または2記載のネガ型水 溶件或光件樹脂組成物。

【請求項4】 (B) 成分の合成において、強酸触媒と して、硫酸、塩酸、硝酸、p-トルエンスルホン酸、お よび塩化アンモニウムの中から選ばれる少なくとも1種 を用いる、請求項1~3のいずれか1項に記載のネガ型 50 受け、その結果、感度にバラツキが生じる、〇経時安定

水溶性感光性樹脂組成物。

【請求項5】 さらに(D)分子内に少なくとも1つの 重合可能なエチレン性不飽和結合を有する光重合性化合 物を含有する、請求項1~4のいずれか1項に記載のネ ガ型水溶性感光性樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はネガ型水溶性感光性 樹脂組成物に関する。さらに詳しくは、CRT用シャド 10 ウマスク、ICチップ搭載用リードフレーム等の製造に おけるエッチング用ホトマスクの形成など、精密加工に 有用なケミカルミーリングに好適に適用され、耐水性に 優れ、長時間のエッチングに耐え得る、水で現像可能な 非クロム系のネガ型水溶性感光性樹脂組成物に関する。

[00002]

【従来の技術】従来、CRT用のシャドウマスクやアパ チャーグリル、ICチップ搭載用リードフレーム等の製 造において、金属基板をエッチングする際のマスク用ホ トレジストとして、カゼインークロム系水溶性感光性樹 20 脂組成物やポリビニルアルコール (PVA) -クロム系 水溶性感光性樹脂組成物等のクロム系水溶性感光性樹脂 組成物が用いられている。

【0003】具体的には、例えばCRT用のシャドウマ

スクの製造では、ニッケル42%含有の42アロイ材、 36%含有のインバー材、低炭素アルミキルド鋼などの 長尺金属薄板 (厚さ0.1~0.3mm程度) を基板と して用い、該基板の両面を脱脂、水洗した後、基板両面 に感光性樹脂組成物 (通常、カゼイン-重クロム酸アン モニウム系水溶性感光性樹脂組成物が用いられる)を塗 30 布し、乾燥、成膜させる。次いで、形成すべき目的の画 像(パターン)を有するマスクパターンを上記両面の塗 膜にそれぞれ密着させて、超高圧水銀灯などの露光機を 用いて露光を行う。このとき、基板両面に形成される画 像(パターン)が一致するよう位置合わせを行う。露光 後、水にて現像を行い、パターンを形成する。続いてこ のパターニングされた基板を無水クロム酸溶液に浸渍 し、水洗後、バーニングすることによって硬膜化処理を 行い、エッチング耐性を向上させた被膜(ホトレジスト 膜) をバターン形成する。そしてこれを、塩化第二鉄液 40 等のエッチング液により、基板のホトレジストパターン

【0004】これらの電子部品の製造工程で用いられる 重クロム酸塩含有水溶性感光性樹脂組成物は、注意深く 取り扱えば解像性、耐エッチング性等において優れたパ ターンが得られるものの、◎暗反応が起きやすく、感度 変化が発生する、◎該暗反応は温度、湿度の影響を強く

非形成部分(基板露出部分)をエッチング(酸性エッチ

ング) し、多数の電子ビーム透過孔を形成した後、ホト

レジスト膜を剥離し、基板を切断してシャドウマスクを

作製している。

には適さない。

性が悪く、保存安定性がない、④有害な重金属塩であ り、その廃液処理は極めて煩雑である、等の問題があ S.

【0005】特に、従来にもまして環境問題が強く指摘 される現代においては、有毒性重金属であるクロム系水 溶性感光性樹脂組成物に代えて、クロム化合物を含まな い非クロム系の水溶性感光性樹脂組成物の開発が急がれ ている。

【0006】エッチングマスクに用いられる非クロム系 感光性樹脂組成物は、これまでにも種々提案されてお り、(i) カゼイン系感光性樹脂組成物、(ii) ポリビ ニルアルコール (PVA) 系感光性樹脂組成物、(ji i) ポリマー若しくはオリゴマー側鎖のカルボキシル基 と、エチレン性二重結合を有するエポキシ基含有化合物 との間で開環付加反応させ、ポリマー側鎖にエチレン件 二重結合を導入した感光性樹脂組成物、(iv) ポリマー 若しくはオリゴマー側鎖のエポキシ基と、エチレン性二 重結合を有するカルボキシル基含有化合物との間で開環 付加反応させ、ポリマー側鎖にエチレン性二重結合を導 られる。

【0007】上記(i)に示すカゼイン系感光性樹脂組 成物としては、特公昭41-7100号公報にカゼイン とアジド化合物からなる組成物が、特開平7-2443 7 4 号公報、特開平8-3 4 8 9 8 号公報にカゼインと アジドグラフトポリマーとナフトキノンジアジドスルホ ン酸ソーダからなる組成物が、特開平11-11942 0 号公報にカゼインと水溶性感光剤からなる組成に有機 酸カルシウムを添加した組成物が、それぞれ開示されて の管理に注意を要する。

【0008】上記 (ii) に示すポリビニルアルコール (PVA) 系感光性樹脂組成物としては、特公昭44-28725号公報にPVAにビニルモノマーをグラフト 共重合させ、あるいはPVAにグリシジルメタクリレー トを付加させた後、これらPVA系樹脂に感光性成分と してテトラゾニウム塩類、ジアジド化合物、ジアゾ樹脂 等を添加した組成物が、特開昭55-23163号公報 にPVAにホルミル基含有スチリルピリジニウム塩を反 応させた組成物が、特公昭56-42859号公報にP 40 VAと縮合ジアゾニウム塩よりなる組成物が、それぞれ 開示されている。しかしながら、これら組成物はその構 造中に水酸基を有するため耐水性が劣る。

【0009】上記 (iii) に示す組成物は、耐エッチン グ特性に優れるものであり、特開昭47-19901号 公報、特開昭48-74594号公報、特開昭49-3 7 7 0 1 号公報、特公昭 5 4 - 1 2 3 3 1 号公報、特開 平 3-172301号公報、特開平 9-80748号公 報、特開2000-221678号公報等で種々提案さ れている。

【0010】しかしながら、特公昭54-12331号 公報に開示されるものは、側鎖にエチレン性二重結合を 有する水溶性ポリマーとアントラキノンスルホン酸また はアントラキノンカルボン酸若しくはそれらの塩とを組 み合せた組成物のみであり、これは昨今の高精細パター ンの形成には耐水性の点において不十分である。

【0011】特開昭47-19901号公報、特開昭4 8-74594号公報、特開平3-172301号公 報、特開2000-221678号公報に示される組成 物はアルカリ水溶性であり、特開平9-80748号公 報に示される組成物はエマルションタイプのアルカリ水 溶性であり、いずれも完全水溶性ではなく、水での現像

【0012】また、特開昭49-37701号公報で は、ポリマー若しくはオリゴマー側鎖に残存するカルボ キシル基を、光重合性モノマーと反応させて第四級アン モニウム塩として水溶性化する技術が開示され、該光重 合性モノマーとして、N-ビニルピロリドン、n-ブト キシメチロールアクリルアミド、イソプトキシメチロー 入した感光性樹脂組成物、などがおもなものとして挙げ 20 ルアクリルアミドが挙げられている。しかしながら、N ビニルピロリドンは水溶件の単官能モノマーであるた め、光重合後に生成するポリビニルピロリドンもまた水 溶性となり、パターンの耐水性に劣る。 n-ブトキシメ チロールアクリルアミド、イソブトキシメチロールアク リルアミドは水不溶性であることから、組成物中に溶解 し得たとしても、現像後、タンク内の現像液中に折出遊 離し、廃液処理に困難を伴うという問題がある。

【0013】上記 (iv) に示す組成物としては、特公昭 43-26869公報、特開2000-181057号 いる。しかしながら、カゼインは腐敗しやすいため、そ 30 公報等に開示されており、また、特開昭50-9732 4号公報では、エポキシプレポリマーに芳香族アミンを 反応させ、さらにこれにグリシジル (メタ) アクリレー トを反応させてエチレン性二重結合を導入する技術が開 示されている。しかしながら上記公報に示される組成物 の現像には有機溶剤系の現像液を用いる必要がある。

> 【0014】上記各組成物のほかにも、例えば、特開昭 51-125169号公報にエチレン性二重結合とエポ キシ基を有するジカルボン酸エステルを用いた組成物 が、特開平10-148938号公報にプロック化イソ シアネートを添加した組成物が、それぞれ開示されてい るが、これらはいずれも有機溶剤で現像するタイプのも

のである。 【0015】また、特開昭51-44922号公報に は、塩基性第三級チッ素を有するポリマーに不飽和エポ キシ化合物を反応させ、これによりボリマーにエチレン 性二重結合を導入して第四級アンモニウム化し、水溶件 化する技術が開示されている。さらに、該ポリマーと光 重合性モノマーを組み合せて用いることが示されてお り、該光重合性モノマーとして、メチレンピス (メタ) 50 アクリルアミド系モノマー、(メタ) アクリルエステル 系モノマー等が挙げられている。しかしながら、これら モノマーは水不溶性のため、現像液表面に游離浮游し て、廃液処理の困難さのみならず、火災の危険、臭気の 拡散等の問題を生じる。

【0016】さらに、特公昭56-20541号公報に PVA系レジストをヨウ素含有液で硬膜する技術が、特 公昭57-23254号、特公昭57-24905号公 報にPVAとジアゾ化合物とでパターニングした後チタ ン化合物で硬膜する技術が、それぞれ提案されている が、いずれも感度、解像性、耐エッチング性等の点にお 10 いて、実用レベルで十分に満足し得る程度にまで至って いない。

【0017】このように、エッチングパターン用ホトマ スクとして、いまだ実稼動ラインでは、カゼインークロ ム系、PVAークロム系等のクロム系水溶性感光性樹脂 組成物が用いられているのが現状である。これはクロム 化合物がきわめて優れた感光特性、耐エッチング特性、 耐水性を有しているため、それに代替し得る材料がなか なか見出せないことによる。

形成のために必然的に水現像工程を経なければならず、 特にCRT用のシャドウマスクやICチップ搭載用リー ドフレーム製造における金属基板エッチング用マスクパ ターン形成においては、ミクロンオーダーあるいはそれ 以下のレベルの極微細パターンの形成が必要である。こ のような極微細なレベルになると、水によるパターン膨 潤がより一層顕著となり、パターンの崩れ、解像性の低 下をきたしやすい。そのため、水現像可能な水溶性であ りながら、光照射後のパターン (光硬化パターン) には 高い耐水性が要求されることとなる。上記従来技術とし 30 て示された組成物は、いまだPVA-クロム系水溶性感 光性樹脂組成物、カゼインークロム系水溶性感光性樹脂 組成物が有する耐水性に劣ることを示しているといえ 3.

【0019】そしてさらに、昨今の新しい表示パネルと して、液晶表示パネルはもちろんのこと、有機EL、無 機EL、フィールドエミッションディスプレー等と、C RTの分野を崩す新たな方式が各種出現してきている状 祝にあっては、シャドウマスクのエッチング工程等に新 ト低減のためからも必要である。

【0020】このため最も望ましい方法は、現在使用さ れているクロム系水溶性感光性樹脂組成物と同等レベル の塩化第二鉄液エッチング特性を有しながら、クロム化 合物を含有しない、水で現像可能な水溶性減光性樹脂組 成物への代替である。これが現在使用されている製造ラ インに受け入れられる最良の方法と考えられる。

## [0021]

【発明が解決しようとする課類】本発明は、従来のクロ ム系水溶性感光性樹脂組成物の代替となる非クロム系の 50 長時間のエッチング性にも耐え得るホトレジストを形成

感光性樹脂組成物であって、特にCRT用シャドウマス ク、ICチップ搭載用リードフレーム等の製造における エッチング用ホトマスクの形成など、精密加工に有用な ケミカルミーリングに好適に適用され、水現像でありな がら耐水性に極めて優れ、酸性エッチングにも耐える、 非クロム系のネガ型水溶性感光性樹脂組成物を提供する ことを目的とする。

#### [0022]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決するために種々検討を重ねた結果、側鎖に導入さ れた複数個のエチレン性二重結合を有するポリマー若し くはオリゴマーと、光重合性モノマーの組合せが最も効 果的であることがわかった。

【0023】ポリマー若しくはオリゴマーにエチレン件 二重結合を導入する方法は、上記従来技術で示したよう に種々提案されている。これらの中でも、ポリマーの側 鎖にカルボキシル基を導入し、次いでその一部のカルボ キシル基に、エポキシ基とエチレン性二重結合を有する 化合物を反応させて、ポリマーの側鎖にエチレン性二重 【0018】水溶性感光性樹脂組成物は、微細パターン 20 結合を導入する方法が、金属への密着の点からも好まし

> 【0024】ただし、エチレン性二重結合を導入したポ リマー若しくはオリゴマーのみでは、得られる水溶性感 光性樹脂組成物は、解像度のみならず耐水性の点におい ても劣る。

【0025】そこで、この不具合を補うために、光重合 性成分としての光重合性モノマーを添加しているが、従 来、光重合性モノマーとしては、良好な耐水性を示すと いう点から、テトラエチレングリコールジ (メタ) アク リレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリ レート、ペンタエリトリトールトリ (メタ) アクリレー ト、ペンタエリトリトールテトラ (メタ) アクリレート 等の(メタ)アクリレート系モノマーが多用されてい る。しかしこれら(メタ)アクリレート系モノマーは水 不溶性であり、有機溶剤可溶型であるため、水溶性感光 性樹脂組成物の調製には適さない。またそれらは光照射 後の耐水性に劣り使用に耐え得るものではなかった。 【0026】すなわち、水溶性感光性樹脂組成物とする

ためには、バインダーとなるポリマーが水溶性であるば たな設備投資は避け、現有設備の継続的有効利用がコス 40 かりでなく、光重合性モノマー自体が水溶性、若しくは 水-水溶性溶媒混合溶剤に可溶であり、光照射後の膜が 強い耐水性を有する必要がある。

> 【0027】本発明者らは、水溶性ポリマーの検討に加 え、光重合性モノマー自体が水溶性、若しくは水-水溶 性溶媒混合溶剤可溶で、光照射後の膜が強い耐水性を有 する化合物を種々検討した結果、特定の水溶性ポリマー と、特定の合成方法により得られる (メタ) アクリルア ミドメチレン基含有化合物との組合せが、完全水溶性 で、光照射後の被膜の耐水性に極めて優れるとともに、

し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。 【0028】 すなわち本発明は、(A) 側鎖に、カルボ キシル基を有する構成単位と、少なくとも1つのエチレ ン性二重結合を有する構成単位を含んでなる水溶性ポリ マー、(B) 強酸触媒の存在下、分子中に少なくとも1 つのアルコール性水酸基を含有する化合物と、下記一般 式(I)

【0030】(式中、R,は水業原子またはメチル基を 装し、R:は水薬原子または炭素原子数1~4のアルキ ル基を表す)で表される化合物とを反応させて得られ 3、下記一的式 (II)

[0031]

【0032】(式中、R.は、上記と同じ意味を表す) で表される(メタ)アクリルアミドメチレン基含有化合 物、および(C)光重合開始剤を含有するネガ型水溶性 暖光性樹脂組成物に関する。

【0033】ここで、上記において、(A) 成分が、下記一般式 (III)

記一般式 (111) 【0034】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & R_3 \\
\hline
 & C \\
\hline
 & C \\
\hline
 & COOH
\end{array}$$
(III)

【0035】 (式中、R」は水素原子またはメチル基を表す) で表される単位と、下記一般式 (IV) 【0036】

$$- \left( \begin{array}{c} R_3 \\ R_2 \\ COOCH_2CH - R_6 - O - C \end{array} \right)$$

$$C = CH_2$$

【0037】 (式中、R、、R、は、それぞれ独立に水素 原子またはメチル基を表し、R。は二価の炭化水素基を 表す) で表される単位を含む共重合体であるのが好まし い。

【0038】また、上記(B)成分を形成する、分子中 に少なくとも1つのアルコール性水酸基を含有する化合 50 物が、多価アルコールであるのが好ましい。

【0039】また、上記(B)成分合成において、強酸 態態として、硫酸、塩酸、硝酸、pートルエンスルホン 酸、および塩化アンモニウムの中から選ばれる少なくと も1種を用いるのが好ましい。

【0040】また本発明は、さらに(D)分子内に少なくとも1つの重合可能なエチレン性不飽和結合を有する 大重合性化合物を含有する、上記ネガ型木溶性感光性樹脂組成物に関する。

### 10 [0041]

(5)

【発明実施の形態】以下、本発明について詳述する。 【0042】(A)成分は、その側鎖に、カルボキシル 基を有する構成単位と、少なくとも1つのエチレン性二 重結合を有する構成単位を含んでなる木溶性ボリマーで

ある。 【0043】(A)成分としては、例えば、(メタ)ア クリル酸のホモポリマーの側鎖、あるいは (メタ) アク リル酸とこれと共重合し得るモノマー (コモノマー) と の共重合体 (コポリマー) の側鎖に、それぞれ存するカ 20 ルボキシル基に、複数個のエチレン性二重結合を導入し たポリマーが挙げられる。上記モノマー (コモノマー) としては、例えば、マレイン酸、イタコン酸、(メタ) アクリレート化合物 [例えば、メチル (メタ) アクリレ ート、エチル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) ア クリレート. 2-エチルヘキシル (メタ) アクリレー ト、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、2-ヒドロ キシプチル (メタ) アクリレート、2-フェノキシー2 ーヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、2-(メ 30 タ) アクリロイルオキシー2-ヒドロキシプロピルフタ レート、グリセリンモノ (メタ) アクリレート、テトラ ヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、ジメチルアミ ノ (メタ) アクリレート、2, 2, 2ートリフルオロエ チル (メタ) アクリレート、2、2、3、3ーテトラフ ルオロプロビル (メタ) アクリレートなど]、フタル酸 誘導体のハーフ (メタ) アクリレート、スチレン、メチ ルビニルエーテル、アクリロニトリル、N-メチロール (メタ) アクリルアミド等が挙げられる。

【0044】本発明では、(A)成分として、下記一般 40 式(III)

【0046】 (式中、R、は水素原子またはメチル基を表す) で表される単位と、下記一般式 (IV) 【0047】

【0048】 (式中、R<sub>1</sub>、R<sub>1</sub>は、それぞれ独立に水素 原子またはメチル基を表し、Rsは二価の炭化水素基を 表す) で表される単位を含む共重合体が好ましい。

【0049】なお、上記一般式(IV)で表される単位は 10 して0.1~10重量%程度が好ましい。 少なくとも2つ以上含まれる。該一般式 (IV) におい て、二価の炭化水素基としては、メチレン基、エチレン 基、プロビレン基等が好ましい。

【0050】(A)成分は、通常のラジカル重合の技術 により容易に製造することができる。該水溶性ポリマー の物性は、上記各種コモノマーを任意に選択することに より、容易に変化させることができ、目的に応じたポリ マーとすることができる。

【0051】(A)成分の好適な合成方法としては、例 えば、(i) ポリマー側鎖に存するカルボキシル基と、 エポキシ基を有するモノマーとを反応させて得る方法。 (ii) 上述した、(メタ) アクリル酸と共重合し得るモ ノマー(コモノマー)として、分子中に水酸基を有する 化合物を用いて、 (メタ) アクリル酸とのコポリマーを 合成し、該コポリマー側鎖の水酸基と、分子中にエチレ ン性二重結合とイソシアネート基を有する化合物とを反 応させて得る方法、(iii)上記(ii)で示すコポリマ 一側鎖の水酸基と、分子中にエチレン性二重結合を有す るカルボキシル基含有化合物とをエステル化反応させて 得る方法、等が挙げられるが、これら方法に限定される 30 合と同様に行うことができる。 ものではない。

【0052】上記(i)の合成方法において、エポキシ 基を有するモノマーとして、例えばグリシジルアクリレ ート、グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエ ーテル、α-エチルグリシジルエーテル、クロトニルグ リシジルエーテル、イタコン酸モノアルキルエステルモ ノグリシジルエステル、3、4-エポキシシクロヘキシ ルメチル (メタ) アクリレート等の、脂環式エポキシ含 有不飽和化合物などが挙げられる。エポキシ基を有する モノマーは1種または2種以上を用いることができる。 【0053】該エポキシ基を有するモノマーの添加量 は、カルボキシル基を有する構成単位(繰返し単位)の 10~50モル%程度が好ましく、特には25~30モ ル%程度である。エポキシ基を有するモノマーの添加量 が少なすぎると、硬化不良による耐エッチング性の低下 を生じやすく、一方、多すぎると粘着性増加による露光 不良等の問題を生じやすい。

【0054】 (i) の合成方法は、具体的には、カルボ キシル基含有ポリマー、エポキシ基を有するモノマー、 触媒、熟重合禁止剤を混合し、50~100℃で、5~ 50 ピリジン、N,N-ジメチルアミノエチルアクリレー

20時間程度加熱、攪拌することにより行うことができ る。温度が高すぎるとモノマー等の熱安定性が悪くなり 好ましくない。

【0055】触媒としては、例えばトリメチルアミン、 トリエチルアミン、ベンジルジメチルアミン等の第三級 アミンや、トリエチルアンモニウムクロライド、ベンジ ルトリメチルアンモニウムブロマイド、ベンジルトリメ チルアンモニウムアイオダイド等の第四級アンモニウム 塩が挙げられる。触媒の使用量は、反応原料混合物に対

【0056】熱重合禁止剤としては、例えばハイドロキ ノン、メチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチ ルエーテル、カテコール、第三プチルカテコール、ピロ ガロール等が挙げられる。勢重合禁止剤の使用量は、反 応原料混合物に対して0.01~1重量%程度が好まし

【0057】上記 (ii) の合成方法において、分子中に 水酸基を有する化合物としては、例えば2-ヒドロキシ エチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロビル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、2-フェノキシ-2-ヒドロキシプロピ ル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

【0058】分子中にエチレン性二重結合とイソシアネ ート基を有する化合物としては、例えばメタクリロイル イソシアネート等が挙げられる。

【0059】 (ii) の合成方法においても、分子中に水 酸基を有する上記コポリマー、分子中にエチレン性二重 結合とイソシアネート基を有する化合物に、触媒、熱重 合禁止剤を添加、混合して、上記 (i) の合成方法の場

【0060】上記 (iii) において、分子中にエチレン 性二重結合を有するカルボキシル化合物としては、例え ば(メタ)アクリル酸、無水マレイン酸等が挙げられ

【0061】 (iii) の合成方法も、上記 (ii) の合成 方法と同様に行うことができる。

【0062】なお、(A)成分が、上記の(メタ)アク リレート化合物をコモノマーとして合成したコポリマー である場合、カルボキシル基を有する繰返し単位の量 40 は、上記コモノマーの種類にもよるが、通常、(A)成 分中の全繰り返し単位に対して、10モル%以上、特に

は20モル%以上であることが好ましい。

【0063】(A)成分はさらに水溶性化等の処理を行 っておくことが好ましい。水溶性化の方法としては、特 に限定されるものでなく、上記した特開昭49-377 01公報等に記載の方法などを好適に利用することがで きる。すなわち、具体的には、アンモニア、またはトリ エチルアミン、トリメチルアミン、トリエタノールアミ ン、N, N-ジメチルアニリン、ピリジン、2-ビニル

ト、N, Nージメチルアミノプロピルメタクリレート等 の第三級アミンを添加することによって第四級化し、水 溶性化を図ることができる。

【0064】(A)成分は1種または2種以上を用いることができる。

【0065】(B)成分は、(b-1)分子中に少なくとも1つのアルコール性水酸基を含有する化合物と、

(b-2) 下記一般式 (I)

[0066]

[0067] (式中、R、は水素原子またはメチル基を 表し、R、は水素原子または炭素原子数~4のアルキ ル基を表す)で表される化合物とを、強酸粒膜の存在下 で反応させて得られる反応生成物であり、具体的には下 配一般式(II)

[0068]

$$H_2C = C - H - C - H_2$$

【0069】 (式中、R:は、上記と同じ意味を表す) で表される (メタ) アクリルアミドメチレン基含有化合 物である。

【0070】上記(b-1)成分である、分子中に少な くとも1つのアルコール性水酸基を含有する化合物とし 30 ては、非塩基性の化合物が好ましく、特には多価アルコ 一ルが好ましい。該多価アルコールとしては、例えば、 エチレングリコール、ジエチレングリコール、1、2-プロパンジオール、1、3-プロパンジオール、1、2 ーブタンジオール、1、3ーブタンジオール、1、4ー ブタンジオール、2、3-ブタンジオール、2-ブテン -1,4ージオール、2ーメチルー2,4ーペンタンジ オール、2-エチル-1、3-ヘキサンジオール、1、 2、6-ヘキサントリオール、ジプロピレングリコー ル、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコー 40 ル、ボリエチレングリコール、ボリプロピレングリコー ル、ネオペンチルグリコール、1,5-ペンタンジオー ル、1、6-ヘキサンジオール、トリメチロールプロバ ン、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン、ポリ オキシエチレン (n) ジグリセリルエーテル、ポリオキ シプロピレン (n) ジグリセリルエーテル、ペンタエリ トリトール、ジベンタエリトリトール、トリス (2-ド ドロキシエチル) イソシアヌレート、3-クロロー1. 2-プロパンジオール、2, 2'-チオジエタノール、

が挙げられる。中でも、エチレングリコール、ジエチレングリコール、1,3 ープロパンジオール、1,6 ーペ タンジオール、トリエチレングリコール、1,6 ーペ サンジオール、トリメテロールプロパン、グリセリン、 ペンタエリトリトール、トリス (2 ーヒドロキシエチ ル)イソンアヌレート等が好ましい。(b-1)成分は 1種または2種以上を用いることができる。

12

【0071】なお、ジエタノールアミン、Nープチルジ エタノールアミン、トリエタノールアミン、トリイソプ 10 ロパノールアミン等も大酸基を2個以上有する化合物で あるが、塩基性であるため、酸触媒作用が減じられるば かりでなく、たとえ酸触媒を過剰にして系を酸性として も、形成された塩の吸水作用によって、縮合物が生成で きても、光重合後の耐水性が劣ったものとなるので、好 ましくない。

【0072】 (b-2) 成分としての上配一般式 (f) (R.、R.は上配で定義したとおり) で表される化合物 (よ 具体的にはN-メチロール (メタ) アクリルアミド、N-メトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N-エトキシメチル (メタ) アクリルアミド、N-プロポキ

20 エトキシメチル (メタ) アクリルアミド、Nープロポキシメチル (メタ) アクリルアミド、Nープトキシメチル (メタ) アクリルアミドが挙げられる。 【0073】(b-1) 成分と(b-2) 成分との縮合

反応において用いる強酸触媒は、該縮合反応系中におい て該縮合反応系中において p H 3程度若しくはそれ以下 の値の強酸性を示すものが好ましい。本発明では強酸触 媒として硫酸、塩酸、硝酸、pートルエンスルホン酸。 塩化アンモニウムから選ばれる少なくとも1種が好まし く用いられる。なお、塩化アンモニウムは縮合反応系中 において、熱により分解してアンモニアが蒸発し、 塩酸 酸性となるので強酸触媒に含まれる。本発明では特に耐 水性に優れた化合物を合成することができるという点か らp-トルエンスルホン酸が好ましい。強酸触媒は1種 または2種以上を用いることができる。強酸触媒の使用 量は、反応系中のpHが上記範囲内となるような量とす る。反応系中のpHが4程度以上では耐水性に優れた化 合物が得られ難い。強酸触媒はそのまま添加してもよ く. あるいは溶媒に溶解させて溶液の形で添加してもよ い。ただし、縮合反応は脱水または脱アルコール反応に より進行することから、溶媒としては、水、アルコール 以外の溶媒に溶解するのが好ましい。

(8)

【0075】強酸触線存在下における(b-1)成分と(b-2)成分との縮合反応により、上記一般式(II)(R:は上記したとおり)で表される(メタ)アクリルアミドメチレン基合有化合物が生成される。

【0076】上記 (B) 成分生成の縮合反応では、一般 式 (I) で表される化合物である (b-2) 成分の仕込 量 (mモル) は、 (b-1) 成分中の水酸基モル数 (n モル) に対して、m=1/n~1.5 n倍モル程度量が 好ましく、より好ましくは1/n~1.2 n倍モル量程 度、特には1/n~1.0 n倍モル量程度である。(b 10 -2) 成分の添加量を上配値関とすることにより、(b -2) 成分の二量体の生成を抑え、(B) 成分である (メタ) アクリルアミドメチレン基含有化合物を高収率 で得ることができる。

【0077】一般式(I)で表される化合物の量が多す ぎると、一応の耐エッチング性があるとはいうものの、 細かく観察すると、光照射後、エッチングされた部分に 庇状に突き出た形で残る被膜(エッチングではホトレジ スト膜寸法より広がって基板が腐食されるため) に欠け がみられる。これはホトレジスト膜が硬くなりすぎたた 20 めと考えられる。なお、上記庇状に突き出た部分に欠け や波打ち等の現象がみられると、エッチング時に、エッ チング液がその部分のみ流動過剰になり、結果としてエ ッチングが過度になされたり、また均一にエッチング液 が行き渡らなくなったりして、最終的な金属エッチング パターンが不均一な物となり不良品となってしまう。一 方、一般式(I)で表される化合物の面が少なすぎると 耐エッチング性に劣る。なお、反応時、モル比を変えて 得た縮合物 (B成分) を2種類以上混合して、本発明の ネガ型水溶性感光性樹脂組成物に配合してもよいが、こ 30 の場合も一般式 (I) で示される化合物の使用量平均は 上記好適範囲内とするのが望ましい。

【0078】上記縮合反応は、不活性の溶媒中で行うこともできるが、無溶媒でもよい。すなわち、一般式

(1) で表される化合物の融点は、例えばN-メチロールアクリルアミドの融点は75℃であり、Cm アルコキンメチル(メタ) アクリルアミドの融点は確認(25℃)以下であるので、溶媒を用いずに、ベンタエリトリトール、トリス(2-ヒドロイイシエチル) イソシアヌレートと高級と彼で反応を進めるととができる。

【0079】総合反応は、産温者しくは加熱(40~1 00℃程度)された乾燥空気を送気しながら行い、生成 される水分、アルコール分を系外へ排出するとよい。反 応は脱水者しくは脱アルコール総合反応により進行する ので、反応率中の水分者しくはアルコール分の管理には 注意を払うを要があるのは当かカコール分の

【0080】このようにして得られる (B) 成分は水溶 性であり、また木一次溶性溶剤混合溶媒に可溶であり、 (=ミヒラーズケトン)、4,4'ービス (ジェチルア 実力) ベンゾフェノン、4-メトキシー4'ージメテル め、異気によって類形を悪くすることが、引火の危険を 50 アミノベンソフェノンをのベンプラェノン誘導体、ベン

引き起こすことがない。また光重合性 (光硬化性) を有 し、しかも光照射後の被膜が強い耐水性を有する。

【0081】 本発明では、これら光重合性モノマー(火 軽化性モノマー)である(B)成分の1種または2種以 上と、(A)成分をおれるやむことにより、大現像可 能でありながら光硬化後の被膜が強い耐水性を示し、塩 化第二族液等の軽性エッチンが耐性、微細パターンの形 成性に優れるとともに、金属基板(特に鉄条金属基位、 への密着性にも優れる、サフロム系のネガ型水溶性感光 性樹脂組成物が得られた。酸組成物は従来のクロム系水

) 性質問題似勢か特られた。該規則の物に従来のフロム条本 密性感光性樹脂組成勢の代替となるものであり、エッチ ングマスク用パターン形成に有利に用いられる。特に、 水溶性ボリマーとして (A) 成分を用い、これを (B) 成分と併用することにより、長時間のエッチングにも耐 太るという優れた効果を参考し

【0082】感光性樹脂組成物中に配合する光重合性モ ノマー (光硬化性モノマー) としては、上記したよう に、従来、その多くのものが水不溶性であり(例えば、 (メタ) アクリルエステル系モノマーなど)、水で現像

(メダ) アクリルエステル系モノマーなど)、水で曳像 の した場合、これらモノマーが現像液表面に遊離浮遊して 廃液処理が困難であるのみならず、引火の危険、臭気の 拡散等の問題を生じる、等々の問題があった。

[0083] なお、末溶性の光重合性モノマーも知られ でいる (例えば、特開昭57-124730号公頼、特 開昭60-101531号公城、特開平3-17230 1号公報、等) が、従来のものは光照射後の耐水性や、 エッチング耐性、解像性等の点において十分でない等の 間に耐えないものであった。 使用に耐えないものであった。

30 【0084】このように、これまで電子部品等の製造に 用いられる極微細パターン形成の使用に耐え得る水溶性 の兆重合性モノマーはなかった。また、水溶性といわれ る感光性熱脂組成物の多くは有機溶剤を含み、現像処理 もアルカリ水溶液により行っていた。

【0085】したがって、木での現像が可能で、エッチ ングマスタ用ホトレジストとして使用可能な、耐水性に 優れる感光性樹脂組成物は、これまで得られていなかっ たが、特定の水溶性ポリマーと特定の光重仓性モノマー とを組み合せた未発明によって、それが別かで可能とな 切った。また本発明により得られる水溶性感光性樹脂組成 物は、長時間エッチングを行った場合でもそれに耐え得 る間エッチング特性を有する。

 (9)

ゾイン、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイン メチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾイ ンイソブチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル等 のベンゾイン誘導体、ベンジル、ジベンジル、ベンジル ジフェニルジスルフィド、ベンジルジメチルケタール等 のベンジル誘導体、キサントン、チオキサントン、2-クロロチオキサントン、2-メチルチオキサントン、 2、4-ジエチルチオキサントン、2-エチルチオキサ ントン等のキサントン誘導体、アセトフェノン、2. ジエトキシアセトフェノン、p-t-ブチルジク 10 2.2.3.3-テトラフルオロプロピル (メタ) アク ロロアセトフェノン、2、2'ージクロロー4ーフェノ キシアセトフェノン等のアセトフェノン誘導体、クロロ アントラキノン、2-メチルアントラキノン、2-エチ ルアントラキノン、2-カルボキシアントラキノン、ア ントラキノン-2-スルホン酸ソーダ、アントラキノン -2,6-ジスルホン酸ソーダ、アントラキノン-2. 7-ジスルホン酸ソーダ等のアントラキノン誘導体 9 ーフェニルアクリジン、1、7ービス(9、9'ーアク リジニル)へプタン等のアクリジン誘導体、フェナント レンキノン、2、4、6-トリメチルベンゾイルジフェ 20 ニルホスフィンオキシド、ビス(2,4,6-トリメチ ルベンゾイル)フェニルホスフィンオキシド、ビス (2.6-ジメトキシベンゾイル)-2,4,4,-ト リメチルーペンチルホスフィンオキシド、オリゴ [2-ヒドロキシー2-メチル-1-[4-(1-メチルビニ ル)フェニル] プロパノン]、1-ヒドロキシシクロへ キシルフェニルケトン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニル-1-プロパン-1-オン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノ キシ)フェニル]-2ヒドロキシ-2-メチル-1-プ ロパン-1-オン、2-ベンジル-2-ジメチルアミノ -1-(4-モルホリノフェニル)ブタノンー1ーオン 等が挙げられる。(C)成分は1種または2種以上を用 いることができる。 (C) 成分は、本来は水溶性である のが好ましいが、その配合量は、組成固形分全量からす れば少ないため、水難溶性であってもよい。

て、光照射後のホトレジスト膜の物性を変えるために に限定されるものでないが、単官能ビニルモノマーと多 官能ビニルモノマーが好ましく用いられる。 【0088】単官能ビニルモノマーとしては、例えば (メタ) アクリルアミド、メチロール (メタ) アクリル

【0087】上記各成分に加えて、さらに、目的に応じ

アミド、メトキシメチル (メタ) アクリルアミド、エト キシメチル (メタ) アクリルアミド、プロポキシメチル (メタ) アクリルアミド、ブトキシメトキシメチル (メ タ) アクリルアミド、メチル (メタ) アクリレート、エ チル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) アクリレー ト、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、2-ヒ 50 い。エチレンオキシド数が14個以上では耐水性に劣る

ドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシ プロピル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、2-フェノキシー2-ヒドロキ シプロピル (メタ) アクリレート、2- (メタ) アクリ ロイルオキシー2-ヒドロキシプロピルフタレート、グ リセリンモノ (メタ) アクリレート、テトラヒドロフル フリル (メタ) アクリレート、ジメチルアミノ (メタ) アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレート、2. 2. 2-トリフルオロエチル (メタ) アクリレート、

16

リレート、フタル酸誘導体のハーフ (メタ) アクリレー ト、N-メチロール (メタ) アクリルアミド等が挙げら れる。 【0089】多官能ビニルモノマーとしては、例えばエ

チレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレン グリコールジ (メタ) アクリレート、テトラエチレング リコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコ ールジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリプロビレングリコールジ (メタ) アクリレート、ブチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アク リレート、1,6-ヘキサングリコールジ(メタ)アク リレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリ レート、グリセリンジ (メタ) アクリレート、ペンタエ リトリトールジ (メタ) アクリレート、ペンタエリトリ トールトリ (メタ) アクリレート、ジペンタエリトリト ールペンタ (メタ) アクリレート、2、2-ビス (4-(メタ) アクリロキシジエトキシフェニル) プロパン、 2、2-ビス(4-(メタ)アクリロキシポリエトキシ プロパンー1ーオン、1-[4-(2-ヒドロキシエト 30 フェニル)プロバン、2-ヒドロキシー3-(メタ)ア クリロイルオキシプロビル (メタ) アクリレート、エチ レングリコールジグリシジルエーテルジ (メタ) アカリ レート、ジエチレングリコールジグリシジルエーテルジ (メタ) アクリレート、フタル酸ジグリシジルエステル ジ(メタ)アクリレート、グリセリントリアクリレー ト、グリセリンポリグリシジルエーテルポリ (メタ) ア クリレート、ウレタン (メタ) アクリレート (例えば、 トリレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレン ジイソシアネート、およびヘキサメチレンジイソシアネ (D) 成分を配合してもよい。(D) 成分としては、特 40 ート等のジイソシアネート化合物と、2-ヒドロキシエ チル (メタ) アクリレートとの反応物) 等が挙げられ る。(D)成分は1種または2種以上を用いることがで きる。 【0090】なお、(D) 成分には水不溶性のものも多

> く含まれるが、本発明では水不溶性の光重合件モノマー の使用は避けたほうが望ましいのは当然のことである。 (D) 成分として本登明では水溶解性のあるポリエチレ ングリコールジ (メタ) アクリレートが好ましく。特に はエチレンオキシド数が7~13個程度のものが好まし

(10)

傾向がみられ、一方、6個以下では水不溶性となり、水 現像後、現像液面に浮遊してしまい、本発明効果が得ら れ難い。

【0091】本発明の水溶性感光性樹脂組成物中、

(A) 成分の配合量は、(A) 成分および(B) 成分の 合計量(固形分)100重量部に対して20~80重量 部が好ましく、特には30~70重量部である。

【0092】(B)成分の配合量は、(A)成分および (B) 成分の合計量 (固形分) 100重量部に対して2 0~80重量部が好ましく、特には30~70重量部で 10 ある。(B)成分の配合量が80重量部超では塗布性に 劣り、また光硬化物が脆くて十分な物性が得られない傾 向があり、20重量部未満では、十分な感度が得られな い傾向がある。

【0093】(C)成分の配合量は、(A)成分および

(B) 成分の合計量(固形分)100重量部に対して 1~10重量部が好ましく、特には0.3~7重量 部である。配合量が0、1重量部未満では十分な感度が 得られないことがあり、一方、10重量部超では、溶解 に低下することがある。また、塗膜表面での光吸収が増 加して、途膜下部での光硬化が不十分となることがあ る。

【0094】(D)成分の配合量は、(B)成分の配合 量の50重量%以下程度が好ましく、特には30重量% 以下程度である。配合量が多すぎると、水現像性、耐水 性など、本目的とする特性が損なわれやすい。

【0095】本発明の水溶性感光性樹脂組成物は、

(A) 成分、(B) 成分に加えて、(C) 成分、さらに レベリング剤、熱重合禁止剤、発色剤、染料、顔料等の 着色剤、充填剤、密着性付与剤、可塑剤等を添加しても よい。なお、これら各任意添加成分は、特に限定される ものでなく、従来から公知のものを用いることができ **5.** 

【0096】このようにして得られる本発明のネガ型水 溶性感光性樹脂組成物は、従来のクロム系水溶性感光性 樹脂組成物での製造装置を変えることなく、エッチング 用ホトレジスト形成を行うことができる。

【0097】例えば、本発明のネガ型水溶性感光性樹脂 40 度20重量%水溶液)を調製した。 組成物をエッチングマスク用ホトレジストとして用いる 場合、ニッケル42%含有の42アロイ材、36%含有 のインバー材、低炭素アルミキルド鋼、ステンレス、銅 等の金属基板上に、(A)成分、(B)成分および

(C) 成分を含有する水溶液に、さらには所望により (D) 成分を添加し、さらに必要に応じて溶剤を添加 し、混合してホトレジスト用途布液として釜布し、乾 燥、成膜させる。溶剤としては水と相容する有機溶媒が 挙げられ、例えばアルコール等が用いられる。次いで、

密着させて露光し、水で現像した後、ベーキング工程経 て、エッチング用ホトレジストとする。なお、シャドウ マスクの製造においては、上述したように、基板の両面 でパターンが一致するよう位置合わせを行う。これによ って電子ビーム用透過孔を形成する。

【0098】塗布手段は特に限定されるものでなく、例 えばロールコーター、カーテンフローコーター、スプレ イコーター、ディップコーター、バーコーターなど、任 意の方法で行うことができる。途膜厚は乾燥膜厚で1~ 30 u m程度が好ましく、特には3~20 u m程度であ

【0099】露光手段は特に限定されるものでなく、例 えば超高圧水銀灯、ケミカルランプ、ブラックライト、 アーク灯など、任意の手段で行うことができる。好まし くは光重合開始剤の吸収波長と一致する波長を出す露光 ランプを選択する。

【0100】現像は、スプレー式、ディップ式、シャワ 一式など、いずれの方法でもよい。本発明では水のみで 現像を行うことができる。水ー水溶性溶媒混合溶剤で行 性が低下し、析出して露光後のパターンの解像性が極端 20 うことができるのはもちろんである。本発明では(B) 成分を配合したことにより、現像後、光重合性モノマー が現像液表面に浮遊析出することがない。また、引火の 危険や臭気の拡散等の問題もない。

> 【0101】本発明の水溶性感光性樹脂組成物は、特に 鉄系合金に対する密着性に優れることから、鉄/ニッケ ル合金、鉄/クロム合金 (ステンレス) 等のエッチング 用ホトマスク形成に好適に用いられる。

[0102]

【実施例】以下に本発明の実施例について説明するが、 は所望により (D) 成分を含み、必要に応じて、さらに 30 本発明はこれによってなんら限定されるものではない。 【0103】I. (A) 成分の調製

> セパラブルフラスコに攪拌機、温度計、還流冷却器、滴 下ロートを取り付け、ポリメタクリル酸20%水溶液 (「ジュリマーAC30H: ; 日本純菜(株)製)50 0 gを入れ、95℃になったところでトリエチルアミン 1.12g、ハイドロキノンモノメチルエーテル0.1 1g、およびグリシジルメタクリレート47、9gを添 加し、9時間反応を行い、水溶性ポリマーを合成した。 次いで、水191.6gを添加し、水溶性ポリマー(濃

【0104】II. (B) 成分の合成

【0105】(合成例1)エチレングリコール62g、 N-メチロールアクリルアミド202g、ハイドロキノ ンモノメチルエーテル0.25gをフラスコに入れ加熱 溶融し、次いでp-トルエンスルホン酸を2.03g添 加し、1.5時間攪拌した。次いで、これに水を加え、 アンモニア水で中和した後、さらに水で希釈して、縮合 生成物(40重量%水溶液)を得た。

【0106】(合成例2)合成例1において、エチレン 該塗膜上に、所望のパターンを有するパターンマスクを 50 グリコール62gの代わりにジエチレングリコール10

6gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.3 7gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重量%水溶液)を得た。

【0107】(合成例3)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりにトリエチレングリコール150gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.7gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重像%水溶液)を得た。

【0108】(合成例4)合成例1において、エチレン グリコール62gの代わりに1,4ープタンジオール910 0gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.2 5gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物 (40電像氷水溶液)を得た。

【0109】 (合成例5) 合成例1 において、エチレングリコール62gの代わりにグリセリン92gを用い、 $N-メチロールアクリルアミドの添加量を202gから303gに代え、<math>p-トルエンスルホン酸の添加量を3.04gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成的 <math>(404 \text{ ag M} \times \text{ kg})$  を得た。

【0110】 (合成例6) 合成例1において、エチレン 20 グリコール62gの代わりにトリメチロールプロパン1 34gを用い、Nーメチロールアクリルアミドの添加量 を202gから303gに代え、pートルエンスルホン 酸の添加量を3.36gに代えた以外は、合成例1と同 様にして総合生成的(40変偶%水溶液)を得た。

【0111】(合成例7)合成例1において、エチレン グリコール62gの代わりにトリス(2-ヒドロキシエ チル)イシンアメレート131度を用い、アーチロー ルアクリルアミドの添加量を202gから152gに代 え、pートルエンスルホン酸の添加量を2.18gに代 30 えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重 量%水溶液)を得た。

【0112】(合成例8)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりにペンタエリトリトール68gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.08gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重解%水溶液)を得た。

【0113】(合成例9)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりに1,6ーヘキサンジオール118gを用い、p・トルエンスルホン酸の溶加量を2.46gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重量が水溶液)を得た。

【0114】(合成例10)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりに1,3一ブロバンジオール76gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.14gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重量%水溶液)を得た。

【0115】(合成例11)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりに1,3-プロパンジオール76gを用い、N-メチロールアクリルアミド20250

gの代わりにNーメトキシメチルメタクリルアミド25 8gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.5 7gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物 (40重異%水溶液)を得た。

【0116】 (合成例12) 合成例1において、N-メ ナロールアクリルアミド202gの代わりにN-メトキ シメチルメタクリルアミド268gを用い、p-トルエ ンスルホン酸の添加量を2.46gに代えた以外は、合 成例1と同様にして縮合生成物 (40重盤%水溶液)を 得た。

【0117】(合成例13)合成例1において、エチレングリコール62gの代わりにベンクエリトリトール6ggの代わりにベンクエリトリトール6gを用い、Nーメチロールアクリルアミド202gの代わりにNーメトキシメチルアクリルアミド172.5gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を1.85gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重量%水溶液)を得た。

【0118】(合成例14)合成例1において、エテレングリコール62gの代わりにベンクエリトリトール62gの代わりにベンクエリトリトール68gを用い、Nーメチロールアクリルアミド202gの代わりにNーメトキシメチルメタクリルアミド193.5gを用い、pートルエンスルホン酸の添加量を2.01gに代えた以外は、合成例1と同様にして縮合生成物(40重量%水溶液)を得た。

【0119】 [エッチングマスク用ホトレジスト]

【0120】(実施例1)

(A) 成分として上記水溶性ポリマー (20重量%溶 液) 50g、(B) 成分として合成例1で得た縮合生成 物 (40重量%水溶液) 22g、(C)成分としてベン ジルジメチルケタール O、 64g、(D)成分としてポ リエチレングリコールジアクリレート(エチレンオキシ ド数8~9個) 1. 9g、熟重合禁止剤としてメチルハ イドロキノン0.04g、染料としてメチレンブルー 11gを混合溶解し、アンモニア水溶液で中和して ホトレジスト用途布液を調製した。該途布液をFe基板 (厚さ125 um) 上にバーコーター (No. 30) に て塗布した後、70℃で乾燥し、ネガマスクを介して5 k W 超高圧水銀灯にて (3. 7 m W × 2 0 秒 (7 4 m J)) 露光した。次いで水道水にてシャワー現像してホ トレジストパターン (光硬化パターン) を得た。これを ドライヤーで乾燥した後、230℃で10分間ベーキン グ処理して、45℃、45ボーメ度の塩化第二鉄溶液に 5分間浸漬してFe基板のエッチングを行った後、水 洗、乾燥して、エッチングされた基板 (サンプル) を得

【0121】 (比較例1) 実施例1において、合成例1 で得た縮合生成物 (18) 成分) 22gの代わりにエチ レングリコールジアクリレート8、8gを用いた以外 は、実施例1と同様にして塗布液を調製した。

【0122】この塗布液を用いて、実施例1と同様に、

Fe基板上に塗布しようとしたところ、エチレングリコ ールジアクリレートの相容性が悪く、また途布性も悪か ったため、ホトレジストパターンの形成には至らなかっ た。

- 【0123】(比較例2)実施例1において、合成例1 で得た縮合生成物 ((B) 成分) 22gの代わりに、エ チレングリコール1.8g、およびN-メチロールアク リルアミド7. 1gを用いた以外は、実施例1と間様に して塗布液を調製し、これを用いてエッチングされた基 板(サンブル)を得た。
- 【0124】 (実施例2~14) 実施例1において、
- (B) 成分として、合成例2~14で得た縮合生成物 (40重量%水溶液) 22gをそれぞれ用いた以外は、 実施例1と同様にして、エッチングされた基板(サンプ
- ル)を得た。 【0125】上記各サンプルを用いて、下記試験方法に より、粘着性、接着性、エッチング性、現像廃液(水面
- 油状分の有無)を評価した。結果を表1に示す。 【0126】 (評価方法)
- 較例2で形成した、露光前(乾燥後)の途膜表面にネガ マスクを密着させ、刺した時のネガマスクの剥れ具合に より評価した。
- 【0128】なお、粘着性が低いほど、感光性樹脂組成 成分の塗膜表面への溶出が少なく、ネガマスクが塗膜表 面と接着してしまう不具合を防

\*露光を行うことができるので好ましい。

るため好ましい.

[0134]

【0129】「接着性] 上記実施例1~14. および比 較例2で形成した、ベーキング処理後のホトレジストパ ターンについて、金属基板との接着性の状態を目視にて 観察した。

- 【0130】なお、接着性が良好であることが、後続の エッチング処理工程におけるマスクとしての働きを有す
- 【0131】 [エッチング性] 上記実施例1~14、お 10 よび比較例2で形成したエッチングサンプルについて、 基板のエッチング状態を目視にて観察した。
  - 【0132】なお、ホトマスクどおりの寸法にエッチン グが行われ、フリンジ等のパターン欠陥がほとんどみら れなかったものを「良好」、エッチングパターンは形成で きたもののフリンジ等のパターン欠陥が多くみられたも のを「不良」、エッチングパターンが形成できなかったも のを「パターン形成されず」として表した。

【0133】 [現像廃液評価] 上記実施例1~14、お よび比較例2で形成した、レジストパターン形成時の理 【0127】 [粘着性] 上記実施例1~14、および比 20 像廃液の状態を、現像廃液回収用タンク内の現像廃液表 面(水面)上における、油状分(分離浮游物)の有無を 目視により観察することで評価した。油状分がないほう が、引火等の危険性が低く、作業場内の環境汚染が少な い点で好ましい。

不具合を防止し、均一なコンタクト* 【表1】						
	(B) 成分 (光重 合性+パー)	粘着性	接着性	耐エッチン グ性	現像廃液評価	
実施例 1	合成例 1	なし	良好	良好	なし	
比較例1	エチレング・リコールジ・アク リレート	-	-	-	_	
比較例2	エチレング・リコール、 N- メチロールアクリルアミト・	ややあり	膨潤刺維	パタン形成さ れず	なし	
実施例2	合成例2	なし	良好	良好	なし	
実施例3	合成例3	なし	良好	良好	なし	
実施例 4	合成例4	なし	良好	良好	なし	
実施例5	合成例5	なし	良好	良好	なし	
実施例6	合成例6	なし	良好	良好	なし	
実施例7	合成例7	なし	良好	良好	なし	
実施例8	合成例8	なし	良好	良好	なし	
実施例9	合成例9	なし	良好	良好	なし	
実施例 10	合成例 10	なし	良好	良好	なし	
実施例 11	合成例 11	なし	良好	良好	なし	
実施例 12	合成例 12	なし	良好	良好	なし	
実施例13	合成例 13	なし	良好	良好	なし	
実施例 14	合成例 14	なし	度好	良好	なし	

23

【0135】上記実施例、比較例の結果から明らかなよ \*等に好適に適用され、水現像可能でありながら耐水性を うに、本発明の水溶性燃光性樹脂組成物は、粘着性がな く、水溶性、接着性、耐水性、耐エッチング性に優れる ことが確認された。また、現像タンク液表面に遊離浮遊 がないため、臭気によって環境を悪くすることや、引火 の危険を引き起こすこともなかった。

[0136]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、従 来のクロム系水溶性感光性樹脂組成物の代替となる非ク ロム系の感光性樹脂組成物であって、特にCRT用シャ 10 に使用できる。 ドウマスク、 I C チップ搭載用リードフレーム等の製造\*

有し、酸性エッチングに優れる、ネガ型水溶性感光性樹 脂組成物が提供される。本発明の水溶性感光性樹脂組成 物は、感光性樹脂組成物に通常要求される感度、解像 力、耐エッチング性、密着性等の各種の特性に優れ、か つ加温時のタックフリー性が抜本的に改善されることか ら、銅配線パターン、ICリードフレーム等のエッチン グ用ホトレジスト、ドライフィルムホトレジスト、ソル ダホトレジスト等の多種類の用途に対して工業的に有利

フロントページの続き

(72)発明者 小畑 健和 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東 京応化工業株式会社内

F ターム(参考) 2H025 AA04 AA07 AA08 AB14 AC01 AD01 BC83 BC85 BC86 CA00 FA17 4J027 AA02 BA07 BA08 BA09 BA14 BA19 BA20 BA21 BA24 CB10 CC05 CD10